（上接A25版）

本次交易中取得的上市公司股份的锁定期承诺与法律法规、监管机构的最新监管意见不相符，大基金将根据法律法规、监管机构的最新监管意见进行相应调整。

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金发行的股份，自发行结束之日起6个月内不以任何方式转让。本次募集配套资金完成后，认购方因公司发生配股、送股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

（六）本次交易摊薄当期每股收益的填补回报安排

1、本次交易对上市公司每股收益的影响

本次交易中，上市公司拟向交易对方发行不超过82,350,000股股份，不考虑配套融资的影响，本次交易后上市公司股本规模将由1,312,061,614股增加至1,394,411,614股，2019年度，本次交易前，上市公司基本每股收益为0.0111元/股，扣非后基本每股收益为-0.0918元/股；本次交易完成后，上市公司基本每股收益为-0.0487元/股，上市公司扣非后基本每股收益为-0.1499元/股。2020年1-7月，本次交易前，上市公司基本每股收益为0.0230元/股，上市公司扣非后基本每股收益为-0.0009元/股；本次交易完成后，上市公司基本每股收益为-0.0007元/股，上市公司扣非后基本每股收益为-0.0250元/股。因此，本次交易完成后，上市公司的扣非前后基本每股收益均将被摊薄。

2、摊薄每股收益的填补回报安排

公司董事会已经制定了摊薄回期回报采取的填补措施，并且公司控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员已对填补措施能够得到切实履行作出承诺。

（七）其他保护投资者权益的措施

上市公司、交易对方及标的公司承诺保证提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。

十二、独立财务顾问的保荐机构资格

上市公司聘请东方证券承销保荐有限公司担任本次交易的独立财务顾问，东方证券承销保荐有限公司经中国证监会批准设立，具有保荐资格。

重大风险提示

一、与本次交易相关的风险

（一）本次交易被暂停、终止或取消的风险

由于本次交易将受到多方因素的影响且方案的实施尚需满足多项条件，本次交易的时间进度存在不确定性，可能因为以下事项的发生而面临被暂停、终止或取消的风险：

1、尽管上市公司已经按照相关规定制定了保密措施，但在本次交易过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次交易被暂停、终止或取消的风险。

2、本次交易推进过程中，市场环境的可能变化、监管机构的审核要求均可能对本次交易方案产生影响，交易双方可能需根据市场环境变化及监管机构的审核要求完善本次交易方案，如交易双方无法就调整和完善交易方案的措施达成一致，则存在被暂停、终止或取消的风险。

3、本次交易过程中可能出现目前不可预知的重大影响事项，而被暂停、终止或取消的风险。

上述情形均可能导致本次交易面临被暂停、终止或取消的风险。如果本次交易需重新进行，则交易将面临重新定价的风险，提请投资者注意。

（二）尚未完成评估备案及估值和交易作价调整的风险

本次交易的标的资产为大基金分别持有的集华投资19.51%的股权以及士兰集昕20.38%的股权。本次交易中，标的资产的交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果基础上经过交易双方协商产生的。标的公司集华投资股东全部权益价值的评估值为174,791.38万元，评估增值率为103.16%；标的公司士兰集昕股东全部权益价值的评估值为364,400.00万元，评估增值率为127.89%，提请投资者注意相关风险。

本次交易的标的资产评估结果会计为108,36652万元，而本次交易作价为112,243.05万元，交易作价高出评估结果3.58%。交易作价高于评估结果系由于评估值未考虑大基金成为上市公司战略股东后产生的战略协同效应和士兰集昕8吋线的稀缺性，提请投资者注意相关风险。

（五）交易对方关业绩承诺的风险

由于本次交易系上市公司收购控股子公司的少数股东权益，标的公司在本次交易前已经由上市公司控制，而且标的资产的评估方法未采用收益法，因此本次交易未设置交易对方对标的公司的业绩承诺条款，提请投资者注意相关风险。

（六）与募集配套资金相关的风险

1、募集配套资金的审批风险

本次交易中，公司拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。前述配套资金将用于8英寸集成电路芯片生产线二期项目（含支付中介机构费用）和偿还上市公司银行贷款。募集配套资金事项尚需股东大会批准、中国证监会审核，提请投资者注意募集配套资金的审批风险。

2、募集配套资金的发行风险

在中国证监会核准后，受股票市场变动、监管政策导向等因素影响，可能引起本次募集配套资金失败或者扣除中介机构费用后本次实际募集资金净额不能满足投资项目的需求。如实际募集资金金额少于拟投入募集资金总额，不足部分将由上市公司以自有资金或其他融资方式解决，从而对本次重组的整合绩效产生不利影响，提请投资者注意募集配套资金的发行风险。

3、募集配套资金的实施风险

本次交易募集配套资金在扣除中介机构费用后将用于8英寸集成电路芯片生产线二期项目和偿还上市公司银行贷款，在募集资金投资项目的建设过程中，可能面临政策变化、技术进步、市场供求、成本变化等诸多不确定因素。因此，配套募集资金投资项目存在未能如期实施，或实施效果与预期值产生偏离的风险，提请投资者注意相关风险。

二、与标的公司经营相关的风险

（一）行业周期性波动风险

半导体行业具有较强的周期性特征，与宏观经济整体发展亦密切相关，目前，由于新型冠状病毒肺炎疫情、贸易摩擦等因素导致全球经济增速存在一定下滑趋势，使得全球半导体产业发展的不确定性进一步增大，也将对包括标的公司在内的行业内企业的经营业绩造成一定的影响。特此提醒投资者关注半导体行业周期性及收入波动风险。

（二）产业政策变化风险

半导体产业作为信息产业的基础，是国民经济和社会发展的战略性产业。近年来，国家出台了一系列鼓励政策以推动我国半导体产业的发展，增强产业创新能力和国际竞争力。如果未来国家相关产业政策支持力度减弱，标的公司的经营业绩将会受到不利影响。特此提醒投资者关注产业政策变化对标的公司经营业绩的风险。

（三）新产品开发风险

半导体消费终端产品市场更新速度较快，标的公司的发展在一定程度上依赖于识别并快速响应客户需求的变化，以开发出符合客户要求且具有较好成本效益的产品，也因此面临着新产品开发的风险。如果标的公司的创新不能紧跟市场产品创新的节奏，将发生较多的资源浪费并丧失市场机会，同时，不能为标的公司的发展提供新的动力。特此提醒投资者关注新产品开发风险。

（四）持续大额资金投入风险

半导体行业具有技术强、投入高、风险大的特征。标的公司为持续保证竞争力，需要在研发、制造等各个环节上持续不断进行资金投入，8吋线的建设需要大额的资本开支及研发投入。特此提醒投资者关注持续大额资金投入风险。

三、财务风险

标的公司士兰集昕最近两年及一期仍处于亏损状态，士兰集昕2018年度、2019年度和2020年1-7月的净利润分别为-13,901.00万元、-17,985.14万元和-9,810.04万元。同时，受宏观经济、行业政策、竞争环境等多方面未知因素的影响，标的公司在经营过程中存在经营风险、市场风险，可能对标的公司的经营成果产生重大影响，因此不排除标的公司未来实际取得的经营成果低于预期的情况。

本次重组实施后，上市公司总股本规模将有所增加，若标的公司盈利能力低于预期，上市公司未来每股收益短期内可能会下滑，每股回报回报可能被摊薄，特此提醒投资者关注本次重组可能摊薄当期回报的财务风险。

四、其他风险

（一）股价波动风险

股票市场投资收益与投资风险并存，股票价格的波动不仅受上市公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，上市公司提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。同时，上市公司一方面将以股东利益最大化作为公司最终目标，提高资产利用效率和盈利水平；另一方面将严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的要求规范运作。本次交易完成后，上市公司将严格按照《股票上市规则》的规定，及时、充分、准确地进行信息披露，以利于投资者做出正确的投资决策。

（二）不可抗力风险

上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素给上市公司带来不利影响的可能性，提请广大投资者注意相关风险。

（三）疫情风险

2020年初，国内外爆发新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“疫情”），多地政府采取了延期复工、管制人口流动、隔离相关人员等措施予以防控。2020年三月中旬以来，国内疫情基本得到有效遏制，但境外疫情加剧。

在国内疫情发生期间，士兰集昕实施了各项严格的防控措施，生产经营活动井然有序，截至目前，疫情没有对士兰集昕的生产经营活动造成实际影响。但由于士兰集昕部分关键原辅材料、设备及备件依赖进口，如果海外疫情不能得到有效控制，可能会影响士兰集昕正常生产经营活动。士兰集昕部分生产设备如光刻机、离子注入机和刻蚀机等需从海外购入，设备进口采购交付时间可能会受到一定的影响。境外设备厂商人员到公司开展业务也有可能受到疫情防控措施的影响，从而影响设备采购、调试进度。

士兰集昕管理层已针对供应链可能存在的风险展开了全方位逐一排查，对风险点均采取了有效的应对方法，并且密切关注国内外疫情防控情况，与供应商保持联络通畅，采取了诸如提前安排采购订单等手段，确保供应安全。由于目前国外疫情仍处于蔓延状态，未来可能会对士兰集昕供应链产生一定影响，敬请广大投资者注意风险。

交易概述

一、本次交易的背景和目的

（一）本次交易的背景

1、国家政策鼓励企业通过兼并重组做大做强

2010年9月，国务院颁布《国务院关于促进企业兼并重组的意见》（国发[2010]27号），提出要进一步推进资本市场企业并购重组的市场化改革，健全市场化定价机制，完善相关规章及配套政策，支持企业利用资本市场开展兼并重组，促进行业整合和产业升级。支持符合条件的企业通过发行股票、债券、可转换债券等方式为兼并重组融资。鼓励上市公司以股权、现金及其他金融创新方式作为兼并重组的支付手段，拓宽兼并重组融资渠道，提高资本市场兼并重组效率。

2014年3月，国务院印发《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（国发[2014]14号），强调兼并重组是企业加强资源整合、实现快速发展、提高竞争力的有效措施，是化解产能严重过剩矛盾、调整优化产业结构、提高发展质量效益的重要途径。同时明确提出将取消下放部分审批事项、简化审批程序、优化信贷融资服务，完善有利于并购重组的财税、土地、职工安置政策等多项有力措施，大力支持企业通过并购迅速做大做强。

2018年11月，证监会修订并发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》，进一步鼓励支持上市公司并购重组，提高上市公司质量，服务实体经济，落实股票停复牌制度改革，减少简化上市公司并购重组预案披露要求。

2019年10月，证监会修订并发布了《重组管理办法（2019年修订）》，旨在准确把握市场规律，理顺重组上市功能，发挥资本市场服务实体经济功能作用，是落实全面深化资本市场改革总体方案的重要举措。

2020年3月，证监会发布了《关于修改〈证券期货投资者保护办法〉，进一步完善上市公司并购重组制度。其中，修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》进一步明确了上市公司控股股东、实际控制人违法违规行为的法律责任，明确了发行股份购买资产存在欺诈的法律责任，依法扩大证券支付工具范围，对证券交易所相应的上市规则的授权规定进行概括性调整，为深化市场化改革预留空间。

上述一系列文件鼓励企业通过资产注入方式做优做强上市公司，鼓励企业通过兼并重组方式进行资源整合。综上，本次交易系在符合国家支持并购重组的相关政策背景下而推进。

2、本次交易符合国家相关产业政策

2000年6月国务院发布《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》（国发[2000]18号），首次专门针对软件和集成电路产业制定了鼓励政策，对集成电路行业的发展具有重要意义。

2010年10月国务院下发《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号），提出着力发展集成电路、高端服务器等核心基础产业的决定。

2011年1月国务院下发《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等七个方面为集成电路产业发展提供了更多的优惠政策。

2014年6月，国务院下发《国家集成电路产业发展推进纲要》，明确提出集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，并决定设立国家产业投资基金，重点支持集成电路制造领域，兼顾设计、封装测试、装备、材料环节，推动企业提升产能水平和实行兼并重组、规范企业治理，形成良性自我发展能力。

2015年6月国务院印发《中国制造2025》发展战略规划，将集成电路作为新一代信息技术产业纳入大力推动突破发展的重点领域，着力提升集成电路设计水平，掌握高密度封装及三维封装技术。

2016年11月国务院下发《十三五国家战略性新兴产业发展规划》（国发[2016]67号），启动集成电路重大生产力布局规划工程，实施一批带动作用强的项目，推动产业能力实现快速跃升。

2018年3月，财政部、国税总局、发改委、工信部联合发布《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税[2018]27号），对集成电路生产企业所得税优惠政策做了进一步规定和调整。

2019年5月，财政部、税务总局发布《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（2019年5月），对依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

2019年10月30日，国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造等列为鼓励发展行业。

国家一系列法规政策的颁布对集成电路产业的发展提供了强有力的支撑。同时，在国家政策的支持引导下，国内拥有自主知识产权的企业也迎来更大的发展机遇。综上，本次交易系在符合国家支持集成电路产业的政策背景下而推进。

3、集成电路市场变化情况

（1）我国集成电路市场规模持续提升

集成电路产值占据半导体行业的80%的市场规模，是电子信息产业的基础性核心产业。近年来，随着全球汽车电子、工业控制、物联网等科技产业的兴起，国内消费电子、汽车电子、信息通讯等集成电路终端应用市场日趋成熟，带动国内集成电路市场持续增长，我国集成电路市场销售规模同比增速持续高于全球。

根据中国半导体行业协会（CSIA）统计，我国半导体行业销售额由2015年的5,610亿元增长至2019年的10,335亿元，年均复合增长率达16.5%，显著高于同期全球半导体市场的增速。根据CSIA预测，未来我国半导体行业规模将保持快速增长，2021年我国半导体行业销售额将达12,935亿元，2019-2021年年均复合增长率将达11.9%。

（2）进口替代空间广阔

我国是全球最大的电子产品制造工厂和大众消费市场，集成电路市场需求接近全球的三分之一。在我国集成电路产业高速发展及庞大市场规模的背后，产业发展不平衡、整体技术水平落后、生产规模集中度低等种种问题不容忽视。根据海关总署的数据，我国集成电路产品的进口额从2015年起已连续四年位列所有进口商品中的第一位。

目前，我国集成电路行业自给率低，对于芯片的进口规模仍然较大，对国外高性能集成电路芯片产品的依赖度仍然较高，包括高压集成电路芯片、功率半导体器件芯片、MEMS芯片等产品绝大部分依赖进口，国产化程度极低，且在技术指标上无法与英飞凌等外企产品相比。不断扩大的中国集成电路市场规模严重依赖于进口，这为我国集成电路产业自主创新和发展提供了机遇，进一步推动了我国集成电路产业链国产替代的进程。

（3）行业战略地位持续提升

近年来，随着国际政治和经济环境的日趋复杂，国际贸易摩擦的日渐加剧，我国更加明确地意识到必须将集成电路国产化提升到国家安全的战略高度，尤其在关乎国家安全和利益的战略领域，必须进行自主研发，开发拥有自主知识产权的核心产品。作为国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，集成电路产业受到国家政策的大力支持。

2014年，国务院出台《国家集成电路产业发展推进纲要》，奠定了我国集成电路的发展方向，随后同年9月国家成立集成电路产业投资基金（“大基金”）正式成立。2020年7月27日，国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，涉及财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策等八个方面，对进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量提供了保障。

4、标的资产（士兰集昕）主要业务开展情况

士兰集昕主要从事8英寸集成电路芯片的生产与销售，产品主要为高压集成电路芯片、功率半导体器件芯片与MEMS传感器芯片等。

2015年，为加快实现制造平台升级，加快公司在中高端芯片领域的突破，在国家和地方政府的支持下，公司开始建设一条8英寸集成电路芯片生产线。2015年底，公司设立士兰集昕作为8英寸生产线的运营主体。2016年3月，公司与大基金签订《2016年投资协议》，公司和大基金分别向士兰集昕投入资金2亿元和6亿元，大大加快了8英寸生产线的建设进程。士兰微所建的8英寸生产线是一条特色工艺的半导体芯片生产线，产品方向包括高压集成电路、半导体功率器件、MEMS传感器等，具有广阔的市场前景。士兰集昕的8英寸生产线有力地提升了公司的制造工艺水平，进一步缩小公司与国际同类型半导体企业之间的差距，并为公司加快进入12英寸生产线创造了条件。

士兰集昕8英寸生产线于2017年6月正式投产，随着工艺平台建设进度加快，芯片产出量创新高，单月芯片产出由2017年底的1.5万片攀升至2020年6月的超过5万片。2019年，在大基金支持下，公司启动8英寸生产线二期项目建设，项目建成后，将形成新增年产43.2万片8英寸芯片的生产能力。士兰集昕6英寸生产线芯片产出的持续增长，对公司集成电路和分立器件产品的营业收入的持续增长起到了积极推动作用。

公司目前是国内最主要的以IDM为特色的综合型半导体产品公司之一。经过20多年不断自主创新，士兰微从集成电路芯片设计业务入手，逐步建成了依托特色工艺的芯片制造平台，并将技术和制造平台延伸至功率器件、功率模块、MEMS传感器等封装领域，建立了较为成熟的IDM（设计与制造一体）经营模式。士兰集昕8英寸生产线是士兰微IDM模式的重要环节，是士兰微产品向中高端领域突破的关键步骤，士兰集昕8英寸生产线的加快建设有力推动了士兰微在高压集成电路、功率半导体器件、MEMS传感器业务的开展。2020年1-6月，公司集成电路和分立器件产品的营业收入分别较去年同期增长55%和35.64%。从细分产品看，2020年1-6月，公司IPM智能功率模块的营业收入和MEMS传感器产品的营业收入分别较去年同期增长90%以上和70%以上。2020年上半年，全部芯片自主研发的电动汽车主电机驱动模块已通过部分客户测试，并开始接获小批量订单。今后，随着士兰集昕8英寸生产线工艺平台进一步升级和产能进一步释放，将持续促进士兰微产品在大客户端的导入和上量，并为下阶段士兰微12英寸生产线产能释放创造有利的市场条件。

5、大基金对公司集成电路生产线的大力支持

为抓住机遇加快公司集成电路芯片生产线的升级，提高公司产品的综合竞争能力，根据2015年4月22日召开的2014年年度股东大会上审议通过的《关于拟投资建设8英寸集成电路芯片生产线的议案》，公司拟投资建设一条8英寸集成电路芯片生产线（以下简称“8吋线”）。2016年3月18日公司及下属子公司士兰集成、集华投资、士兰集昕等与大基金共同签署了投资协议，根据投资协议大基金将投资6亿元以支持公司8吋线建设。2017年6月底，公司8吋线正式投产，产出逐步增加。2019年8月，为进一步提高芯片产出能力，提升制造工艺水平，士兰集昕拟对8吋线进行技术改造，公司开始建设8吋线二期项目，其中大基金投资6亿元，以支持公司发展。8吋线建设，有力地提升了公司的制造工艺水平，进一步缩小与国际同类型半导体企业之间的差距，并为后期公司加快进入12吋线创造了条件。2017年6月8吋线正式投产至今，8吋线芯片产量持续上升对公司的整体营收增长起了积极推动作用；在国家和地方政府的大力支持下，公司开始向“成为具有自主品牌、具有国际一流竞争力的综合性半导体产品供应商”这一目标迈进。

大基金历次对公司8英寸集成电路芯片生产线的投资方式、估值、双方是否有承诺收益或款项偿付具体情况如下：

大基金主要以向集华投资和士兰集昕增资的方式投资公司8英寸集成电路芯片生产线（8英寸生产线）的一期项目和二期项目，具体如下：

投资日期[注1]	投资项目	大基金投资方式	出资方式	作价	是否有承诺收益或款项偿付
2016年3月	8英寸生产线一期项目	以20,000万元认缴集华投资新增的20,000万元注册资本	货币出资	1元/1元注册资本	否
2016年3月		以40,000万元认缴士兰集昕新增的40,000万元注册资本	货币出资	1元/1元注册资本	否
2019年8月	8英寸生产线二期项目	以30,000万元认缴集华投资新增的30,000万元注册资本	货币出资	1元/1元注册资本	否
2019年8月		以20,000万元认缴士兰集昕新增的17,574.5962万元注册资本	货币出资	1.13800623元/1元注册资本	否

注：投资日期为投资协议签署日期。

（1）2016年3月，大基金6亿元投资8英寸生产线一期项目

2016年2月22日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于与国家集成电路产业投资基金股份有限公司共同投资建设8英寸芯片生产线的议案》。2016年3月18日，公司、士兰集成、集华投资、士兰集昕与大基金签署了《关于杭州集华投资有限公司及杭州士兰集昕微电子有限公司之投资协议》（以下简称“《2016年投资协议》”）。

根据《2016年投资协议》，大基金本次投资共计出资60,000万元，包括两轮增资：第一轮增资集华投资，第二轮增资士兰集昕。具体如下：

①第一轮增资（增资集华投资）

大基金和士兰微以货币方式分别出资20,000万元，共同增资集华投资，合计出资40,000万元。增资前，集华投资为士兰微全资子公司，注册资本为1,000万元；增资后，集华投资注册资本增加至41,000万元。本次增资的价格为1元/1元注册资本。

第一轮增资前后集华投资的股权结构如下：

股东名称	增资后		增资前	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
士兰微	21,000	51.22%	1,000	100.00%
大基金	20,000	48.78%	–	–
合计	41,000	100.00%	1,000	100.00%

2016年3月21日，杭州市高新区（滨江）市场监督管理局核准了本次增资的工商变更登记。

大基金和士兰微同时于2016年3月31日实缴完成了本次新增注册资本共40,000万元。

②第二轮增资（增资士兰集昕）

大基金和集华投资以货币方式分别出资40,000万元，共同增资士兰集昕，合计出资80,000万元。增资前，士兰集昕的注册资本为2,000万元；增资后，士兰集昕注册资本增加至82,000万元。本次增资的价格为1元/1元注册资本。

第二轮增资前后士兰集昕的股权结构如下：

股东名称	增资后		增资前	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
士兰微	1,800	2.20%	1,800	90.00%
士兰集成	200	0.24%	200	10.00%
集华投资	40,000	48.78%	–	–
大基金	40,000	48.78%	–	–
合计	82,000	100.00%	2,000	100.00%

2016年3月21日，杭州市市场监督管理局经开分局核准了本次增资的工商变更登记。

集华投资于2016年3月31日完成实缴本次新增注册资本40,000万元，大基金于2016年4月5日完成实缴本次新增注册资本40,000万元。

（2）2019年8月，大基金5亿元投资8英寸生产线二期项目

在大基金本次投资8英寸生产线二期项目之前，公司、士兰集成与杭州高新科技创业服务有限公司（以下简称“高新科创”）于2018年8月以货币方式共同出资50,000万元认购了士兰集昕新增的43,939.5563万元注册资本，其中，公司以货币出资12,000万元，认缴注册资本105,454,935元；士兰集成以货币出资8,000万元，认缴注册资本70,303,290元；高新科创以货币出资30,000万元，认缴注册资本263,637,338元。本次增资完成后，士兰集昕的注册资本由820,000,000元增加至1,259,395,563元。增资前后士兰集昕的股权结构如下：

股东名称	增资后		增资前	
	出资额（元）	持股比例	出资额（元）	持股比例
士兰微	123,454,935	9.80%	18,000,000	2.20%
士兰集成	72,303,290	5.74%	2,000,000	0.24%
高新科创	263,637,338	20.94%	–	–
集华投资	400,000,000	31.76%	400,000,000	48.78%
大基金	400,000,000	31.76%	400,000,000	48.78%
合计	1,259,395,563	100.00%	820,000,000	100.00%

为投资建设士兰集昕8英寸生产线二期项目，2019年8月26日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设士兰集昕二期项目的议案》。2019年8月29日，公司、集华投资、士兰集成、士兰集昕与大基金签署了《关于杭州士兰集昕微电子有限公司之投资协议》（以下简称“《2019年投资协议》”）。

根据《2019年投资协议》，大基金本次投资共计出资50,000万元，用于对集华投资和士兰集昕增资，具体如下：

增资集华投资

大基金和公司分别出资30,000万元和31,500万元，共同增资集华投资，合计出资61,500万元，出资方式均为货币。集华投资的注册资本由41,000万元增加至102,500万元。本次增资的价格为1元/1元注册资本。

增资前后集华投资的股权结构如下：

股东名称	增资后		增资前	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
士兰微	52,500	51.22%	21,000	51.22%
大基金	50,000	48.78%	20,000	48.78%
合计	102,500	100.00%	41,000	100.00%

大基金和公司对集华投资的本次增资分两期缴纳，第一期缴纳情况为：公司于2019年11月26日完成实缴注册资本21,000万元，大基金于2019年11月29日完成实缴注册资本20,000万元；第二期缴纳情况为：公司于2020年4月14日完成实缴注册资本10,500万元，大基金于2020年4月24日完成实缴注册资本10,000万元。

2019年12月5日，杭州市高新区（滨江）市场监督管理局核准了本次增资的工商变更登记。

②增资士兰集昕

大基金和集华投资共同出资80,000万元增资士兰集昕，其中：大基金以货币出资20,000万元，认缴新增注册资本175,745,962元；集华投资以货币出资60,000万元，认缴新增注册资本527,237,887元。增资后士兰集昕的注册资本由1,259,395,563元增加至1,962,379,412元。本次增资的价格为1.13800623元/1元注册资本。

增资前后士兰集昕的股权结构如下：

股东名称	增资后		增资前	
	出资额（元）	持股比例	出资额（元）	持股比例
士兰微	123,454,935	6.29%	123,454,935	9.80%
士兰集成	72,303,290	3.68%	72,303,290	5.74%
高新科创	263,637,338	13.44%	263,637,338	20.94%
集华投资	927,237,887	47.25%	400,000,000	31.76%
大基金	575,745,962	29.34%	400,000,000	31.76%
合计	1,962,379,412	100.00%	1,259,395,563	100.00%

集华投资和大基金对士兰集昕的2019年增资分两期缴纳，第一期缴纳情况为：集华投资于2019年12月9日完成实缴注册资本351,491,924.67元；第二期缴纳情况为：集华投资于2020年4月26日完成实缴注册资本175,745,962.33元，大基金于2020年4月24日完成实缴注册资本175,745,962.00元。

2019年12月10日，杭州市市场监督管理局钱塘新区分局核准了本次增资的工商变更登记。

在大基金上述2016年和2019年的增资中，公司与大基金均没有承诺收益或款项偿付的约定。

（二）本次交易的目的

1、本次交易符合上市公司发展战略

公司战略目标是以国际上先进的IDM大厂为学习标杆，争取早日成为具有自主品牌、具有国际一流竞争力的综合性半导体产品供应商。长期以来，公司凭借“设计与制造一体”（IDM）模式，在集成电路、半导体功率器件、MEMS传感器、LED等多个技术领域持续进行生产资源、研发资源的投入，取得了长足的进步。公司通过在多个芯片设计领域的积累，推出了许多有针对性的芯片产品和系统应用解决方案，积极响应了国内客户芯片国产化的需求，特别在白色家电等领域打破了国外厂商的长期垄断。今后，公司还将继续全力推动特殊工艺研发、制造平台的发展，加快8吋线产品技术平台的导入，积极拓展产能。

通过本次交易，公司将增加对标的公司的持股比例和控制力，进一步推动8吋集成电路芯片生产线特殊工艺研发、制造平台的发展，增强公司生产制造能力和未来盈利能力。本次交易符合公司长期发展战略，有利于推护公司全体股东的利益。

2、大基金成为公司直接股东后将提升公司价值

根据国务院印发的《国家集成电路产业发展推进纲要》，大基金是支持国家产业发展战略的产业投资基金，对我国集成电路的产业发展起着引导性作用。引入大基金成为公司的主要股东，有利于提升公司在集成电路产业的市场地位。大基金投资了众多集成电路产业链的上下游公司，而且对所投资的公司具有一定的影响力，能为上市公司带来更多的业务协同。大基金成为公司股东后，不仅能继续对公司的8吋线项目的生产和建设提供支持，也能将在资金、产业方面对公司其他产品线提供支持。大基金作为公司重要的股东，未来将持续提升公司的整体价值，从而切实提高公司综合实力、核心竞争力和可持续发展能力。

3、本次收购集华投资、士兰集昕部分少数股权之收购比例和收购时点的考虑

（1）大基金于2016年3月向集华投资以现金方式增资人民币2亿元，该部分投资款占目前集华投资总注册资本的19.51%。大基金于2016年3月向士兰集昕以现金方式增资人民币4亿元，该部分投资款占目前士兰集昕总注册资本的20.38%。

本次收购大基金所持集华投资、士兰集昕部分少数股权的比例系根据大基金于2016年投资集华投资、士兰集昕所形成的股东权益确定。因此，公司与大基金经过协商一致后同意，公司拟通过发行股份方式购买大基金持有的集华投资19.51%的股权以及士兰集昕20.38%的股权。

（2）此次公司收购大基金持有的士兰集昕部分少数股东权益，是针对大基金对8英寸生产线一期项目投入6亿元资本金所形成的权益部分，不包括大基金对8英寸生产线二期项目投入的5亿元资本金所形成的权益部分，主要是考虑以下几方面因素：首先，士兰集昕8英寸生产线业务开展已对士兰微电子带来业务贡献，并且士兰集昕运营状况持续向好，未来盈利可期。其次，士兰集昕6英寸生产线二期项目还处于建设中，还需要大量的资金。公司拟通过本次重组配套募集资金筹措资金不超过112,200.00万元，其中，不超过56,100.00万元用于8英寸生产线二期项目中，加快项目建设。第三，实施本次交易将实现大基金在上市公司层面持股，有利于士兰微更长远的发展。

4、本次收购集华投资、士兰集昕部分少数股权的必要性和原因

（1）公司目前是通过与大基金合资的集华投资持有士兰集昕股权，公司以间接和直接方式享有的士兰集昕权益比例合计为34.13%，士兰集昕作为公司未来主要的业务增长点，其中一期项目的工艺技术水平和产能已逐渐达到设计要求，因将成为公司重要的收入来源，2020年1-6月已实现营业收入3.33亿，公司有必要增加权益比例。本次重组换股完成后，公司直接和间接持有的士兰集昕股权权益比例上升至63.73%。

（2）经过近三年的建设运行，士兰集昕高压集成电路、高压超结MOS管、高密度低压沟槽栅MOS管、TRENCH肖特基管、大功率IGBT等多个工艺平台和产品系列导入量产，对公司未来几年业务成长形成关键支撑。

截至2020年6月底，士兰集昕已建成年产8英寸芯片60万片的生产能力，士兰集昕已展现出良好的基本面，未来将实现盈利，本次重组从长期看有利于增厚上市公司业绩。

（3）近年来，随着国际政治和经济环境的日趋复杂，国际贸易摩擦的日渐加剧，进一步催化了芯片国产替代进程，公司作为以IDM模式（设计与制造一体化）为主要发展模式的综合型半导体产品公司，迎来了发展的战略机遇期，引入大基金作为战略股东，将过去的项目合作上升到股权层面的多元化合作方式，拓展合作的渠道和方式。芯片产业作为资本密集型、技术密集型行业，需要资本长期投入。士兰集昕二期项目预计总投资15亿元，公司在士兰集昕一期项目已经顺利实施取得先发优势的情况下，仍需要保持财务稳健，降低经营风险。

因此本次交易以换股方式收购标的公司部分少数股权，大基金从过去的项目合作上升到股权层面的全方位合作，成为公司重要战略股东。大基金具有丰富的战略资源，有利于促进公司各子业务板块的全面发展，提高经营风险保障，符合公司的长远利益，有利于公司早日实现既定的战略目标。

（4）大基金继续保有士兰集昕部分股权，继续为8英寸生产线二期项目分担一定的投资风险，体现了大基金对公司的支持。

综上，通过本次交易，公司将增加对标的公司的持股比例和控制力，进一步推动8英寸集成电路芯片生产线特殊工艺研发、制造平台的发展，增强公司生产制造能力和未来盈利能力。本次交易符合公司长期发展战略，有利于推护公司全体股东的利益。

二、本次交易的决策过程和批准情况

（一）本次交易已履行的决策程序和批准情况

1、上市公司已履行的决策和审批程序

2020年7月24日，上市公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于（杭州士兰微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案）》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

2020年12月30日，上市公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了本次交易正式方案。

2、交易对方已履行的决策和审批程序

2020年7月24日，交易对方大基金已经与上市公司签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》。2020年12月30日，交易对方大基金已经与上市公司签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》。

交易对方大基金已经履行通过内部决策审议程序，同意本次交易方案。

（二）本次交易尚需获得的批准和核准程序

本次交易方案尚需获得下述备案、批准或核准方可实施，包括但不限于：

1、标的资产评估报告取得有权国有资产监管部门备案；

2、上市公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；

3、中国证监会核准本次交易。

上述批准或核准均为本次交易的前提条件，本次交易能否取得上述备案、批准、核准以及取得上述备案、批准、核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。本次交易方案的实施以取得上述全部备案、核准为前提，未取得前述备案、核准不得实施。

三、本次交易的方案概况

本次交易方案包括发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金两部分。

（一）发行股份购买资产

1、发行对象及购买资产

本次交易前，上市公司直接持有集华投资51.22%的股权，直接持有士兰集昕6.29%的股权。集华投资为士兰集昕的第一大股东，其直接持有士兰集昕47.25%的股权。

上市公司拟通过发行股份方式购买大基金持有的集华投资19.51%的股权以及士兰集昕20.38%的股权。除本次交易外，上市公司没有对收购集华投资、士兰集昕剩余股权与包括大基金在内的其他股东签署过相关安排或协议。

本次交易完成后，上市公司将直接持有集华投资70.73%的股权，直接持有士兰集昕26.67%的股权。集华投资对士兰集昕的持股比例保持不变。上市公司将通过直接和间接方式合计持有士兰集昕63.73%的股权权益。

本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为士兰控股，实际控制人仍为陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋